

2018-2024年中国半导体封 测行业深度研究与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

www.abaogao.com

一、报告报价

《2018-2024年中国半导体封测行业深度研究与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/I5853261QS.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话：400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真：010-60343813

Email：sales@abaogao.com

联系人：刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

封测是封装和测试制程的合称，其中封装是为保护芯片不受环境因素的影响，而将晶圆代工厂商制造好的集成电路装配为芯片的过程，具有连接芯片内部和外部电路沟通的作用；测试环节的目的在于检查出不良芯片。作为半导体核心产业链上重要的一环，封测虽在摩尔定律驱动行业发展的时代地位上不及设计和制造，但随着“超越摩尔时代”概念的提出和到来，先进封装成为了延续摩尔定律的关键，在产业链上的重要性日渐提升。

全球半导体封装测试业整体随着全球半导体产业景气呈现增长态势，市场需求不减，大陆半导体封测产业有望最先受益。在《国家集成电路产业发展纲要》发布之后，国家加快了集成电路产业的布局，封装测试作为集成电路产业链后端关键环节也获得了快速发展，根据《中国半导体封装产业现状与展望》报告显示，2016年我国IC封测市场规模达到1523亿元，大陆半导体封测产业已经处于全球领先地位。2014-2018年全球半导体封测业市场规模（亿美元）数据来源：公开资料整理

智研数据研究中心发布的《2018-2024年中国半导体封测行业深度研究与市场供需预测报告》共十二章。首先介绍了半导体封测相关概念及发展环境，接着分析了中国半导体封测规模及消费需求，然后对中国半导体封测市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国半导体封测面临的机遇及发展前景。您若想对中国半导体封测有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 半导体封测行业相关基础概述

1.1 半导体封测的定义及分类

1.1.1 半导体封测的界定

1.1.2 半导体封测的分类

1.1.3 半导体封测的特性

1.2 半导体封测行业特点分析

1.2.1 市场特点分析

1.2.2 行业经济特性

1.2.3 行业发展周期分析

1.2.4 行业进入风险

1.2.5 行业成熟度分析

第二章 2012-2017年中国半导体封测行业市场发展环境分析

2.1 中国半导体封测行业经济环境分析

2.1.1 中国经济运行情况

1、国民经济运行情况GDP

2、消费价格指数CPI、PPI

3、全国居民收入情况

4、恩格尔系数

5、工业发展形势

6、固定资产投资情况

2.1.2 经济环境对行业的影响分析

2.2 中国半导体封测行业政策环境分析

2.2.1 行业监管环境

1、行业主管部门

2、行业监管体制

2.2.2 行业政策分析

1、主要法律法规

2、相关发展规划

2.2.3 政策环境对行业的影响分析

2.3 中国物流行业总体发展情况

2.3.1 物流总额情况分析

2.3.2 物流总费用情况分析

2.3.3 物流业增加值情况分析

2.3.4 物流固定资产投资分析

2.3.5 物流业景气情况分析

第三章 中国半导体封测行业上、下游产业链分析

3.1 半导体封测行业产业链概述

3.1.1 产业链定义

- 3.1.2 半导体封测行业产业链
- 3.2 半导体封测行业主要上游产业发展分析
 - 3.2.1 上游产业发展现状
 - 3.2.2 上游产业供给分析
 - 3.2.3 上游供给价格分析
 - 3.2.4 主要供给企业分析
- 3.3 半导体封测行业主要下游产业发展分析
 - 3.3.1 下游产业发展现状
 - 3.3.2 下游产业需求分析
 - 3.3.3 下游主要需求企业分析
- 3.4 中国半导体封测行业业务量情况分析
 - 3.4.1 半导体封测业务量走势
 - 3.4.2 业务量产品结构分析
 - 3.4.3 业务量区域结构分析
 - 3.4.4 业务量企业结构分析

第四章 国际半导体封测行业市场发展分析2013年～2016年全球主要封测代工国家市占率变化

数据来源：公开资料整理

- 4.1 2012-2017年国际半导体封测行业发展现状
 - 4.1.1 国际半导体封测行业发展现状
 - 4.1.2 国际半导体封测行业发展规模
 - 4.1.3 国际半导体封测主要技术水平
- 4.2 2012-2017年国际半导体封测市场研究
 - 4.2.1 国际半导体封测市场特点
 - 4.2.2 国际半导体封测市场结构
 - 4.2.3 国际半导体封测市场规模
- 4.3 2012-2017年国际区域半导体封测行业研究
 - 4.3.1 欧洲
 - 4.3.2 美国
 - 4.3.3 日韩
- 4.4 2018-2024年国际半导体封测行业发展展望
 - 4.4.1 国际半导体封测行业发展趋势

4.4.2 国际半导体封测行业规模预测

4.4.3 国际半导体封测行业发展机会

第五章 2012-2017年中国半导体封测行业发展概述

5.1 中国半导体封测行业发展状况分析

5.1.1 中国半导体封测行业发展阶段

5.1.2 中国半导体封测行业发展总体概况

5.1.3 中国半导体封测行业发展特点分析

5.2 2012-2017年半导体封测行业发展现状

5.2.1 2012-2017年中国半导体封测行业发展热点

5.2.2 2012-2017年中国半导体封测行业发展现状

5.2.3 2012-2017年中国半导体封测企业发展分析

5.3 中国半导体封测行业细分市场概况

5.3.1 市场细分充分程度

5.3.2 细分市场结构分析

5.3.3 电商半导体封测市场

5.3.4 同城半导体封测服务市场

5.3.5 国际件半导体封测市场

5.4 中国半导体封测行业发展问题及对策建议

5.4.1 中国半导体封测行业发展制约因素

5.4.2 中国半导体封测行业存在问题分析

5.4.3 中国半导体封测行业发展对策建议

第六章 中国半导体封测行业运行指标分析及预测

6.1 中国半导体封测行业企业数量分析

6.1.1 2012-2017年中国半导体封测行业企业数量情况

6.1.2 2012-2017年中国半导体封测行业企业竞争结构

6.2 2012-2017年中国半导体封测行业财务指标总体分析

6.2.1 行业盈利能力分析

6.2.2 行业偿债能力分析

6.2.3 行业营运能力分析

6.2.4 行业发展能力分析

6.3 中国半导体封测行业市场规模分析及预测

6.3.1 2012-2017年中国半导体封测行业市场规模分析

6.3.2 2018-2024年中国半导体封测行业市场规模预测

6.4 中国半导体封测行业市场供需分析及预测

6.4.1 中国半导体封测行业市场供给分析

1、2012-2017年中国半导体封测行业供给规模分析

2、2018-2024年中国半导体封测行业供给规模预测

6.4.2 中国半导体封测行业市场需求分析

1、2012-2017年中国半导体封测行业需求规模分析

2、2018-2024年中国半导体封测行业需求规模预测

第九章 中国半导体封测行业市场竞争格局分析

7.1 中国半导体封测行业竞争格局分析

7.1.1 半导体封测行业区域分布格局

7.1.2 半导体封测行业企业规模格局

7.1.3 半导体封测行业企业性质格局

7.2 中国半导体封测行业竞争五力分析

7.2.1 半导体封测行业上游议价能力

7.2.2 半导体封测行业下游议价能力

7.2.3 半导体封测行业新进入者威胁

7.2.4 半导体封测行业替代产品威胁

7.2.5 半导体封测行业现有企业竞争

7.3 中国半导体封测行业竞争SWOT分析

7.3.1 半导体封测行业优势分析（S）

7.3.2 半导体封测行业劣势分析（W）

7.3.3 半导体封测行业机会分析（O）

7.3.4 半导体封测行业威胁分析（T）

7.4 中国半导体封测行业投资兼并重组整合分析

7.4.1 投资兼并重组现状

7.4.2 投资兼并重组案例

7.5 中国半导体封测行业竞争策略建议

第八章 中国半导体封测行业领先企业竞争力分析

8.1 长电科技

8.1.1 企业发展基本情况

8.1.2 企业主营业务分析

8.1.3 企业竞争优势分析

8.1.4 企业经营状况分析

8.1.5 企业最新发展动态

8.1.6 企业发展战略分析

8.2 星科金朋

8.2.1 企业发展基本情况

8.2.2 企业主营业务分析

8.2.3 企业竞争优势分析

8.2.4 企业经营状况分析

8.2.5 企业最新发展动态

8.2.6 企业发展战略分析

8.3 中芯国际

8.3.1 企业发展基本情况

8.3.2 企业主营业务分析

8.3.3 企业竞争优势分析

8.3.4 企业经营状况分析

8.3.5 企业最新发展动态

8.3.6 企业发展战略分析

8.4 日月光

8.4.1 企业发展基本情况

8.4.2 企业主营业务分析

8.4.3 企业竞争优势分析

8.4.4 企业经营状况分析

8.4.5 企业最新发展动态

8.4.6 企业发展战略分析

8.5 力成科技

8.5.1 企业发展基本情况

8.5.2 企业主营业务分析

- 8.5.3 企业竞争优势分析
- 8.5.4 企业经营状况分析
- 8.5.5 企业最新发展动态
- 8.5.6 企业发展战略分析

第九章 2018-2024年中国半导体封测行业发展趋势与投资机会研究

- 9.1 2018-2024年中国半导体封测行业市场发展潜力分析
 - 9.1.1 中国半导体封测行业市场空间分析
 - 9.1.2 中国半导体封测行业竞争格局变化
 - 9.1.3 中国半导体封测行业互联网+前景
- 9.2 2018-2024年中国半导体封测行业发展趋势分析
 - 9.2.1 中国半导体封测行业品牌格局趋势
 - 9.2.2 中国半导体封测行业渠道分布趋势
 - 9.2.3 中国半导体封测行业市场趋势分析
- 9.3 2018-2024年中国半导体封测行业投资机会与建议
 - 9.3.1 中国半导体封测行业投资前景展望
 - 9.3.2 中国半导体封测行业投资机会分析
 - 9.3.3 中国半导体封测行业投资建议

第十章 2018-2024年中国半导体封测行业投资分析与风险规避

- 10.1 中国半导体封测行业关键成功要素分析
- 10.2 中国半导体封测行业投资壁垒分析
- 10.3 中国半导体封测行业投资风险与规避
 - 10.3.1 宏观经济风险与规避
 - 10.3.2 行业政策风险与规避
 - 10.3.3 上游市场风险与规避
 - 10.3.4 市场竞争风险与规避
 - 10.3.5 技术风险分析与规避
 - 10.3.6 下游需求风险与规避
- 10.4 中国半导体封测行业融资渠道与策略
 - 10.4.1 半导体封测行业融资渠道分析
 - 10.4.2 半导体封测行业融资策略分析

第十一章 2018-2024年中国半导体封测行业盈利模式与投资战略规划分析

11.1 国外半导体封测行业投资现状及经营模式分析

11.1.1 境外半导体封测行业成长情况调查

11.1.2 经营模式借鉴

11.1.3 国外投资新趋势动向

11.2 中国半导体封测行业商业模式探讨

11.2.1 行业主要商业模式

11.2.2 自建模式

11.2.3 特许加盟模式

11.2.4 代理模式

11.3 中国半导体封测行业投资发展战略规划

11.3.1 战略优势分析

11.3.2 战略机遇分析

11.3.3 战略规划目标

11.3.4 战略措施分析

11.4 最优投资路径设计

11.4.1 投资对象

11.4.2 投资模式

11.4.3 预期财务状况分析

11.4.4 风险资本退出方式

第十二章 (ZYZF) 研究结论及建议

12.1 研究结论

12.2 投资建议

12.2.1 行业发展策略建议

12.2.2 行业投资方向建议

12.2.3 行业投资方式建议 (ZYZF)

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/l5853261QS.html>